



2021 年中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会（第 24 届）

2021 China IC Manufacturing Annual Conference and Supply Chain Innovation Forum (24th)



2021年中国集成电路制造年会 暨供应链创新发展大会（第24届）

2021 China IC Manufacturing Annual Conference
and Supply Chain Innovation Forum (24th)

新开局 新挑战 芯生机 芯活力
New Opening, New Challenge, IC Opportunities, Chip Energy

11月01-03日 中国·广州
November 1st-3rd
Guangzhou, China



关注会议



总目录

Contents

一、理事长欢迎词.....	3
WELCOME ADRESS FROM THE PRESIDENT OF IC BRANCH, CSIA.....	4
二、大会组织机构	
CONFERENCE ORGANIZERS.....	5
三、大会概览	
OVERVIEW OF CONFERENCE PROGRAM.....	7
四、装备与零部件创新论坛	
EQUIPMENT AND COMPONENTS INNOVATION FORUM.....	8
五、高峰论坛	
SUMMIT FORUM.....	10
六、汽车芯片应用牵引创新发展论坛	
AUTOMOTIVE CHIP APPLICATION TRACTION INNOVATION AND DEVELOPMENT SYMPOSIUM.....	15
七、IC 制造生态发展论坛	
IC MANUFACTURING INDUSTRIAL ECO-DEVELOPMENT SYMPOSIUM.....	17
八、IC 设计与制造协同论坛	
IC DESIGN AND MANUFACTURING COLLABORATION FORUM.....	20
九、功率及化合物半导体论坛	
POWER & COMPOUND SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT SYMPOSIUM.....	22
十、智能传感器专题论坛	
INTELLIGENT SENSOR SYMPOSIUM.....	25
十一、2021 中国半导体材料创新发展大会	
2021 CHINA SEMICONDUCTOR MATERIALS INNOVATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE.....	27
十二、半导体产业投资合作论坛	
SEMICONDUCTOR INVESTMENT & COOPERATION SYMPOSIUM.....	29
十三、集成电路质量保障和提升论坛	
HIGH-QUALITY DEVELOPMENT IN INTEGRATED CIRCUITS FORUM.....	31
十四、集成电路检测与测试创新论坛	
IC INSPECTION AND TESTING INNOVATION FORUM.....	33
十五、展览展示	
CONFERENCE EXHIBITON.....	35
十六、温馨提示	
CONFERENCE GUIDELINE.....	42



中国半导体行业协会集成电路分会理事长欢迎词

秋高气爽，风清云淡。在充满诗意的深秋，我们相聚在羊城，隆重举行“第 24 届中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会”。我代表主办本届大会的中国半导体行业协会集成电路分会、中国集成电路创新联盟向关心和支持本届大会的各位领导、各位嘉宾和产业界朋友们表示热烈欢迎和衷心感谢！

每年一届的中国集成电路制造年会都得到了各级政府领导的高度重视。每年一届的中国集成电路制造年会群英荟萃。政府领导和行业协会、会员单位代表、科研院所、高等院校和国内外集成电路设计、制造、封测、设备、材料企业的企业家和专家相聚一堂，共同探讨在中国经济新常态下集成电路产业发展的新方向、行业发展的创新点。

中国集成电路创新联盟旗下的封测、装备、材料、零部件和检测与测试各个创新联盟首次携手参与本届供应链创新发展大会，共同探讨产业链协同发展大计，彰显了“**新开局、新挑战、芯生机、芯活力**”的大会主题，是本届大会的新亮点。

我相信，本届大会必将开成“产业政策推动会、产品技术发布会、企业合作交流会”；各位领导和嘉宾、产业界同仁将会在秀丽的羊城度过难忘的时光，留下美好的记忆。



中国半导体行业协会集成电路分会理事长、中国集成电路创新联盟副理事长兼秘书长、国家

科技重大专项 02 专项技术总师 叶甜春



WELCOME FROM THE PRESIDENT OF IC BRANCH OF CHINA SEMICONDUCTOR INDUSTRY ASSOCIATION

In this beautiful and poetic autumn, we gather in Guangzhou to participate in CICD 2021. I, on behalf of organizers of this conference including China Semiconductor Industry Association IC Branch and China IC Innovation Alliance, welcome and thank all leaders, guests and friends from the industry for your caring and support for this conference!

Every year, government leaders at all levels take CICD conference seriously, and the conference will gather together all well-known figures in the industry. Government leaders, industry associations and representatives from member organizations, research institutes, universities, as well as entrepreneurs and experts from Chinese and foreign IC design, manufacturing, packaging and testing, device and material enterprises gather together to discuss new developments and innovations of IC industry in new normal of China's economy.

For the first time, innovation alliances of China IC Innovation Alliance including the packaging and testing, device, materials, parts and components, inspection and testing will participate in this year's CICD to discuss synergistic development of the industry chain, which highlights the conference theme of "New Beginning, New Challenges, Chip Vitality, Chip Dynamic", and will be new highlights of this year's conference.

I believe that this conference will be one for "industry policy promotion, product and technology launch, and enterprise cooperation and exchange"; all leaders, guests and colleagues in the industry will spend an unforgettable time in beautiful Guangzhou, and leave with great memories.



Tianchun Ye

President of China Semiconductor Industry Association IC Branch, Vice President and Secretary General of China Integrated Circuit Innovation Alliance, Technical Director of National Science and Technology Major Project (Project 02)



大会组织机构

CONFERENCE ORGANIZATIONS

指导单位 Guiding Units:

广东省工业和信息化厅
Department of Industry and Information
Technology of Guangdong Province
广东省发展和改革委员会
Guangdong Provincial Development and Reform
Commission
广东省科学技术厅
Department of Science and Technology of
Guangdong Province
广东省教育厅
Department of Education of Guangdong
Province
广州市政府
The People's Government of Guangdong
Municipality

主办单位 Organizers:

中国半导体行业协会
China Semiconductor Industry Association
国家科技重大专项 02 专项实施管理办公室
Implementation Management Office of National
Major science and technology projects for Large-
scale Integrated Circuit Manufacturing
Equipment and Complete Process
中国集成电路创新联盟

China Integrated Circuit Innovation Alliance

承办单位 Co-Organizers:

中国半导体行业协会集成电路分会
IC Branch of China Semiconductor Industry
Association
中国半导体行业协会支撑业分会
Material Branch of China Semiconductor Industry
Association
广东省集成电路行业协会
China IC Inspection and Testing Innovation
Alliance
中国集成电路封测创新联盟
China IC packaging and testing Innovation
Alliance

中国集成电路装备创新联盟

China Integrated Circuit Equipment Innovation
Alliance

中国集成电路材料创新联盟

China Integrated Circuit Materials Innovative
Alliance

中国集成电路零部件创新联盟

China Integrated Circuit Components Innovation
Forum

中国集成电路检测与测试创新联盟

China IC Inspection And Testing Alliance

粤港澳大湾区半导体产业联盟

Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay
Area Semiconductor Industry Alliance

广州市半导体协会

Guangzhou Semiconductor Industry Association

广东省大湾区集成电路与系统应用研究院

Guangdong Greater Bay Area Institute of
Integrated Circuit and System

工业和信息化部电子第五研究所

CEPREI

协办单位 Co-Organizers:

《微电子制造》编辑部

CEPEM

上海芯奥会务服务有限公司

Shanghai Xin Ao Conference Service Co., Ltd

北京市半导体行业协会

Beijing Semiconductor Industry Association

上海市集成电路行业协会

Shanghai IC Industry Association

天津市集成电路行业协会

Tianjin IC Industry Association

重庆市半导体行业协会

Chongqing Semiconductor Industry Association

江苏省半导体行业协会

Jiangsu Province Semiconductor Industry
Association

浙江省半导体行业协会

Zhejiang Province Semiconductor Industry



Association

安徽省半导体行业协会

Anhui Province Semiconductor Industry

Association

陕西省半导体行业协会

Shanxi Province Semiconductor Industry

Association

湖北省半导体行业协会

Hubei Province Semiconductor Industry

Association

深圳市半导体行业协会

Shenzhen Semiconductor Industry Association

成都市集成电路行业协会

Chengdu IC Industry Association

厦门市集成电路行业协会

Xiamen IC Industry Association

大连市半导体行业协会

Dalian Semiconductor Industry Association

合肥市半导体行业协会

Hefei Semiconductor Industry Association

南京市集成电路行业协会

Nanjing IC Industry Association

苏州市集成电路行业协会

Suzhou IC Industry Association

无锡市半导体行业协会

Wuxi Semiconductor Industry Association

支持媒体 Support Media:

《中国电子报》、《电子工业专用设备》、《半导体行业》、《中国集成电路》、《半导体技术》、微电子制造、半导体行业观察、《集成电路应用》、全球半导体观察、半导体芯科技、电子创新网、智东西、爱集微



CICD 2021 大会概览

OVERVIEW OF CONFERENCE PROGRAM

2021 年 11 月 1 日 星期一 Nov.1 st , 2021 Monday		
10:00-11:10	中国半导体行业协会集成电路分会理事会 (闭门) COUNCIL MEETING OF IC BRANCH, CSIA (CLOSED-DOOR)	一楼开源厅 Kaiyuan Room, 1F
13:30-14:15	中国集成电路零部件创新联盟理事会 (闭门) COUNCIL MEETING OF CHINA IC COMPONENTS INOVATION ALLIANCE (CLOSED-DOOR)	一楼开源厅 Kaiyuan Room, 1F
17:00-17:30	装备与零部件联盟专家委员会年度联合会议 (闭门) ANNUAL JOINT MEETING OF THE EXPERT COMMISSION OF EQUIPMENT AND COMPONENTS INNOVATION ALLIANCE (CLOSED-DOOR)	一楼开源厅 Kaiyuan Room, 1F
13:30-14:15	中国集成电路装备创新联盟成员大会 (闭门) GENERAL MEETING OF CHINA IC EQUIPMENT INDUSTRY INNOVATION STRATEGIC ALLIANCE (CLOSED-DOOR)	一楼黄埔 A 厅 Huangpu Barllroom A, 1F
14:30-17:30	装备与零部件创新论坛 (闭门) EQUIPMENT AND COMPONENTS INNOVATION FORUM (CLOSED-DOOR)	一楼黄埔 A 厅 Huangpu Barllroom A, 1F
13:30-15:00	中国集成电路材料创新联盟会员大会暨理事会 (闭门) MEMBER AND COUNCIL MEETING OF CHINA INTEGRATED CIRCUIT MATERIALS INNOVATION ALLIANCE (CLOSED-DOOR)	一楼黄埔 B 厅 Huangpu Barllroom B, 1F
15:30-17:30	ICMtia 供需专场对接会 (闭门) DOCKING MEETING OF ICMtia SUPPLY AND DEMAND (CLOSED-DOOR)	一楼黄埔 B 厅 Huangpu Barllroom B, 1F
2021 年 11 月 2 日 星期二 Nov. 2 nd , 2021 Tuesday		
08:30-17:40	高峰论坛 SUMMIT FORUM	黄埔厅全厅 Huangpu Ballroom
13:30-17:30	半导体产业发展趋势分析 SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT ANALYSIS FORUM	一楼开源厅 Kaiyuan Room, 1F
13:30-17:30	ICMtia 综合场对接会 (闭门) DOCKING MEETING OF ICMtia SUPPLY AND DEMAND (CLOSED-DOOR)	一楼开创厅 Kaichuang room, 1F
18:30-21:00	欢迎晚宴 WELCOME BANQUET	一楼黄埔全厅 Huangpu Ballroom, 1F
2021 年 11 月 3 日 星期三 Nov. 3 rd , 2021 Wednesday		
08:30-12:00	汽车芯片应用牵引创新发展论坛 AUTOMOTIVE CHIP APPLICATION TRACTION INNOVATION AND DEVELOPMENT SYMPOSIUM	一楼黄埔 C 厅 Huangpu Barllroom C, 1F
08:30-16:45	IC 制造生态发展论坛 IC MANUFACTURING INDUSTRIAL ECO-DEVELOPMENT SYMPOSIUM	一楼黄埔 A 厅 Huangpu Barllroom A, 1F
09:00-12:00	IC 设计与制造协同论坛 IC DESIGN AND MANUFACTURING COLLABORATION FORUM	二楼香雪厅 A Xiangxue Barllroom A, 2F
09:00-16:45	功率及化合物半导体论坛 POWER & COMPOUND SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT SYMPOSIUM	一楼开创厅 Kaichuang Room, 1F
09:00-16:45	智能传感器专题论坛 INTELLIGENT SENSOR SYMPOSIUM	一楼开源厅 Kaiyuan Room, 1F
09:00-11:50	2021 中国半导体材料创新发展大会 2021 CHINA SEMICONDUCTOR MATERIALS INNOVATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE	一楼黄埔 B 厅 Huangpu Barllroom B, 1F
09:00-12:00	集成电路质量提升论坛 HIGH-QUALITY DEVELOPMENT IN INTEGRATED CIRCUITS FORUM	一楼开放厅 Kaifang Room, 1F
13:30-17:45	半导体产业投资合作论坛 SEMICONDUCTOR INVESTMENT & COOPERATION SYMPOSIUM	一楼黄埔 B 厅 Huangpu Barllroom B, 1F
13:15-18:00	ICMtia 先进材料 Workshop (闭门) ICMtia Advanced Materials Workshop (Closed)	一楼开放厅 Kaifang Room, 1F



14:00-17:00	集成电路检测与测试创新论坛 IC INSPECTION AND TESTING INNOVATION FORUM	一楼黄埔厅 C Huangpu Barllroom C, 1F
-------------	--	------------------------------------

装备与零部件创新论坛

Equipment And Components Innovation Forum

2021 年 11 月 1 日 星期一 14:15-17:00 广州黄埔君澜酒店一楼黄埔 A 厅 Nov. 1 st , 2021 Monday 14:15-17:00 Huangpu Ballroom A, 1F, NARADA Hotel, Guangzhou	
14:15-14:30	来宾入场签到 Sign in
主持人: 张国铭 中国集成电路装备创新联盟秘书长、华海清科股份有限公司总经理 Moderator: Guoming ZHANG , Secretary-General of China IC Equipment Industry Innovation Strategic Alliance, President fo Hwatsing Technology co.,Ltd.	
致词讲话 Addresses	
14:30-15:10	<ol style="list-style-type: none"> 1、雷震霖 中国集成电路零部件创新联盟理事长 Zhenlin LEI, President of IC Components Inovation Alliance 2、赵晋荣 中国集成电路装备创新联盟理事长、北方华创科技集团股份有限公司董事长 Jinrong ZHAO, President of IC Equipment Industry Innovation Strategic Alliance, Chairman of NAURA Technology Group Co., Ltd 3、叶甜春 中国半导体行业协会集成电路分会理事长、中国集成电路创新联盟副理事长兼秘书长、国家科技重大专项 02 专项技术总师 Tianchun YE, President of China Semiconductor Industry Association IC Branch; Vice President of China Semiconductor Industry Association; Head of Overall Panel of National Science and Technology Major Projects (02); 4、部委领导 Related Leader
15:10-15:30	茶歇&合照 Networking Break
专题报告 Keynote Speech	
题目待定 To be Decided	
15:30-15:50	康劲 博士 北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司总经理、芯链融创集成电路产业发展(北京)有限公司董事长 Dr. Jin KANG , General Manager of STIC
15:50-16:10	关于发展我国半导体装备与零部件产业的思考 Reflections on Developing China's Semiconductor Equipment and Parts Industry



	赵晋荣 中国集成电路装备创新联盟理事长、北方华创科技集团股份有限公司董事长 Jinrong ZHAO , President of IC Equipment Industry Innovation Strategic Alliance, Chairman of NAURA Technology Group Co., Ltd
16:10-16:30	打造高质量的、有国际竞争力的半导体设备公司 Developing High Quality and Globally Competitive Semiconductor EquipmenEnterprise 尹志尧 中国集成电路装备创新联盟副理事长、中微半导体(上海)股份有限公司董事长兼首席执行官 Gerald YIN , Vice-president of IC Equipment Industry Innovation Strategic Alliance , Chairman and CEO of Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC)
16:30-16:50	题目待定 To be Decided 郑广文 中国集成电路零部件创新联盟副理事长兼秘书长、沈阳富创精密设备股份有限公司董事长 Guangwen ZHENG, Vice president and Secretary General of IC Components Inovation Alliance & Chairman of Shenyang Fortune PRECISION Equipment Co., Ltd.
16:50-17:00	总结讲话 Concluding Remarks
18:00-20:30	晚宴-装备与零部件联盟全体参会人员 二楼香雪 B 厅 Membership Dinner-Equipment And Components Innovation Alliance, Xiangxue Ballroom B, 1F

*实际议程以当天为准 The actual agenda is subject to the current day



高峰论坛日程

Overview of Summit Forum

2021 年 11 月 2 日 星期二 08:30-17:40 广州黄埔君澜酒店一楼黄埔全厅
Nov. 2nd, 2021 Tuesday 08:30-17:40 1F, Huangpu Ballroom, NARADA Hotel, Guangzhou

特别鸣谢/Sponsors:



开幕式 Opening Ceremony	
主持人 / Moderator	<p>叶甜春 中国半导体行业协会集成电路分会理事长、国家科技重大专项 02 专项技术总师、中国集成电路创新联盟副理事长兼秘书长 Tianchun YE, President of Academy of Integrated circuit, Chinese Academy of Sciences; Head of Overall Panel of National Science and Technology Major Projects (02); Vice President of China Semiconductor Industry Association</p>
时间/Time	内容 / Content
	<p>大会致辞 Welcome Remarks</p> <p>中国半导体行业协会领导 Leader from China Semiconductor Industry Association 广东省领导 Leader from Guangdong Province 广州市领导 Leader from Guangzhou 国家科技部领导 Leader from the Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China 工业和信息化部领导 Leader from the Ministry of Industry and Information Technology 国家发改委领导 Leader from the National Development and Reform Commission</p>
08:50-09:30	仪式环节 Publishing & Signing & Awarding Ceremony
09:30-09:40	<p>黄埔集成电路产业政策推荐 IC Industry Policy Of Huangpu District</p> <p>陈勇 广州黄埔区区委书记、广州开发区管委会常务副主任</p>



	Yong CHEN , Secretary of Guangzhou Huangpu District & Executive deputy director of Guangzhou Development Zone
09:40-10:00	茶歇与展览交流 Networking Break
高峰论坛 —— 特邀专家报告 Summit Forum —— Plenary Talk	
主持人: 于燮康 中国半导体行业协会集成电路分会常务副理事长 Xiekang YU , Executive Vice-president of IC Branch of China Semiconductor Industry Association	
10:00-10:20	中国集成电路制造产业现状与展望 Current Status and Outlook of China IC Manufacturing Industry
	叶甜春 中国半导体行业协会集成电路分会理事长, 国家科技重大专项 02 专项技术总师, 中国集成电路创新联盟副理事长兼秘书长 Tianchun YE , President of Academy of Integrated circuit, Chinese Academy of Sciences; Head of Overall Panel of National Science and Technology Major Projects (02); Vice President of China Semiconductor Industry Association
10:20-10:40	第三代半导体创新与发展 Innovation And Development Of The Third Generation Semiconductor
	郝跃 中国科学院院士 Yue HAO , Academician of CAS
10:40-11:00	三维集成技术释放芯动能——思考与实践 3D Integration Architectures To Unleash The Core Energy Of IC Industry——Thinking And Practicing
	杨士宁 博士 长江存储科技有限责任公司首席执行官 Simon Yang , PhD, CEO of Yangtze Memory Technologies Co., Ltd
11:00-11:20	技术演进+应用驱动 功率领跑千亿赛道 Power Semiconductor Leads Industry Track By Technology Evolution And Application Driving
	李虹 博士 华润微电子有限公司首席运营官 Dr. Hong Li , Executive Director and COO of China Resources Microelectronics Limited Company
11:20-11:40	粤港澳大湾区集成电路产业链协同发展的探索与实践 Exploration And Practice Of Synergistic Development Of Integrated Circuit Industry In The Greater Bay Area
	陈卫 广州粤芯半导体技术有限公司总裁及首席执行官 TONY CHEN , CEO & President of CanSemi Technology Inc.
11:40-12:00	以产融结合的综合服务 助力我国集成电路产业跨越发展 Comprehensive Services Based On The Combination Of Industry And Finance, Boost The



	Leapfrog Development Of Chinese IC Industry
	杜洋 芯鑫融资租赁有限责任公司董事长兼总裁 Yang DU , Chairman and President of SINO IC LEASING Co., Ltd.
12:00-13:20	自助午餐 Buffet Lunch
高峰论坛 — 产业报告 Summit Forum --- Keynote Speech	
主持人: 秦舒 中国半导体行业协会集成电路分会秘书长 Moderator: Shu QIN , Secretary of IC Branch of China Semiconductor Industry Association	
13:20-13:40	国产大硅片崛起的机遇与挑战 The Opportunity and Challenge of Domestic 300mm Si Wafer Supply
	邱慈云 博士 上海硅产业集团股份有限公司总裁/上海新昇半导体科技有限公司 CEO Dr. TZU-YIN CHIU , National Silicon Industry Group President / Zing Semiconductor Corporation CEO
13:40-14:00	碳中和背景下的半导体产业机遇 Semiconductor Development Opp. in the Context of Carbon Neutralization
	曹志平 意法半导体副总裁、中国区总经理 Henry Cao , Vice President of STMicroelectronics, Managing Director China
14:00-14:20	国产显示价值链赛道规模初具, 只待显示驱动芯片产能释放补短板 The Scale Of Domestic Display Value Chain Track Is Beginning To Take Shape, And Only The Capacity Of Display Driver Chip Is Released To Make Up For Shortcomings
	张晋芳 北京集创北方科技股份有限公司创始人兼首席执行官 (CEO) Frank ZHANG , founder and CEO of Chipone Technology (Beijing) Co., Ltd
14:20-14:40	晶圆厂 MES 发展历程和实践感悟 MES History of Fab & Practice Summary
	吕凌志 博士 上扬软件(上海)有限公司 董事长兼 CEO Dr. Lu Lingzhi , FA Software (Shanghai) Co., Ltd, Managing Director & CEO
14:40-15:00	面向集成电路产业链的质量保障技术 The Quality Assurance Technology for Integrated Circuit Industry Chain
	恩云飞 工业和信息化部电子第五研究所总工程师 Yunfei EN , The Chief Engineer of China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute
15:00-15:15	茶歇与展览交流 Networking Break
主持人: 王国平 中国半导体行业协会集成电路分会特聘顾问 Moderator: Guoping WANG , Distinguished Consultant of IC Branch of China Semiconductor Industry	



Association	
15:15-15:35	移动操作机器人如何助力半导体晶圆厂实现智能化升级 How to realize Intelligent Manufacturing in SEMI FAB by using AGV、AMR
	黄建龙 深圳优艾智合机器人有限公司 半导体自动化事业部总经理 Kent Huang , Semiconductor AMHS BU General Manager of Shenzhen Youibot Robotics Co.,Ltd.
15:35-15:55	电子生态系统的下一波演进: 挑战和未来 Continuing Evolution of the Electronics Ecosystem: Challenges & Future
	凌琳 西门子 EDA 全球副总裁, 中国区总经理 Pete Ling , Vice President of China Country Manager, Siemens EDA
15:55-16:15	独立第三方芯片测试产业崛起之路 The rise of independent third-party IC testing industry
	张亦锋 广东利扬芯片测试股份有限公司董事总经理 Yifeng Zhang , CEO of Guangdong Leadyo IC Testing Co.,Ltd.
16:15-16:35	加快安全智能边缘计算的发展 Accelerating the Secure Intelligent Edge
	钱志军 恩智浦半导体大中华区副总裁 Jason Qian , VP, Global Sales & Marketing, Greater China, NXP Semiconductors
圆桌对话——新开局、新挑战、芯生机、芯活力 Round table dialogue --- New Opening, New Challenge, IC Opportunities, Chip Energy	
主持人: 陈南翔 中国半导体行业协会集成电路分会常务副理事长/长江存储执行董事长 Moderator: Nanxiang CHEN , Vice President of IC Branch of China Semiconductor Industry Association, Executive Chairman of Yangtze Memory Technologies Co., Ltd	
16:35-17:25	嘉宾 (排名不分先后) Guests(in no particular order) 陈卫 广州粤芯半导体技术有限公司总裁兼 CEO TONY CHEN , CEO & President of CanSemi Technology Inc. 赵晋荣 北方华创科技集团股份有限公司董事长 Jinrong ZHAO , Chairman of NAURA Technology Group Co., Ltd. 陈伟 矽力杰半导体技术有限公司总裁以及首席执行官 Wei CHEN , Chairman of Silergy Corp. 陈刚 比亚迪半导体股份有限公司总经理 Gang CHEN , General Manager of BYD Micro. 王淑敏 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司董事长兼 CEO Shumin WANG , Chairman & CEO of Anjimirco Shanghai Co.,Ltd 郑力 江苏长电科技股份有限公司董事、首席执行官 Li ZHEGN , Director of Board, CEO of JCET Group Co., Ltd.
	欢迎晚宴 Welcome Banquet 抽奖 Lucky Draw
18:20-21:00	



特别鸣谢：中国电子系统工程第二建设有限公司、北方华创科技集团股份有限公司、安集微电子科技（上海）股份有限公司、深圳中科飞测科技股份有限公司、通富微电子股份有限公司、赛默飞世尔科技

China Electronics System Engineering No.2 Construction Co., Ltd., NAURA Technology Group Co., Ltd., Anjimirco Shanghai Co.,Ltd., Skyverse Technology Co., Ltd., Tongfu Microelectronics Co., Ltd., Thermo Fisher Scientific

*实际议程以当天为准 The actual agenda is subject to the current day



汽车芯片应用牵引创新发展论坛

Automotive chip application traction innovation and development Symposium

2021 年 11 月 3 日星期三 08:30-12:00 广州黄埔君澜酒店 一楼黄埔 C 厅
Nov. 3rd, 2021 Wednesday 08:30-12:00 Huangpu Barllroom C, 1F, NARADA Hotel,
Guangzhou

特别鸣谢/Sponsors:  广州万协通信息技术有限公司
Wise Security Technology (Guangzhou) Co., Ltd

主持人: 任艳 工业和信息化部电子第五研究所元器件与材料研究部副主任 Moderator: Yan Ren , Deputy Director of Components and Materials Research Department, The Fifth Institute of Electronics, Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China	
08:30-08:40	签到 Sign in
08:40-08:45	领导致辞 Opening address
08:45-09:05	车载芯片的应用现状与发展趋势 Application Status and Development Trend of the Automobile Chip 张进 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院副院长 Zhang Jin , GAC Automotive Research & Development Center Vice President
09:05-09:25	智联万物, 自万协通 5G 超级 eSIM 芯开始 Zhilian everything From WST 5g super ESIM core 王礼宇 广州万协通信息技术有限公司总经理 Liyu WANG , General manager of WISESECURITY TECHNOLOGY (GUANGZHOU) CO.,LTD
09:25-09:45	汽车电子产业的国产化芯片应用 Application of domestic chip in Chinese automotive electronics industry 陈鑫 惠州市德赛西威汽车电子智能座舱事业单元副总经理 Xin Chen , Executive Vice General Manager of Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. BU Instrument Cluster & Infotainment
09:45-10:05	模拟芯片在新能源汽车的应用 Application of Analog IC in NEVs 陈伟 矽力杰股份有限公司 董事长 Wei Chen , Chairman of Silergy Co., Ltd
10:05-10:20	茶歇与展览交流 Networking Break
10:20-10:40	新能源汽车功率半导体技术及其进展 Automobile Power Semiconductor Technology and Progress 刘国友 株洲中车时代电气股份有限公司新型功率半导体器件国家重点实验室常务副主任, 中车科学家 Guoyou Liu , CRRC Scientist, Executive deputy director for State Key Laboratory of Advanced Power Semiconductor Devices
10:40-11:00	汽车芯片国产替代与质量提升技术 Localized Substitution and Quality Improvement Technology of Automotive Chips 路国光 工业和信息化部电子第五研究所国家重点实验室副主任 Guoguang Lu , Deputy Director of the State Key Laboratory, The Fifth Institute of



	Electronics, Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China
11:00-11:20	<p>中国汽车芯片产业的机遇挑战与应对策略 Opportunity, Challenge and Strategy of China Automotive Chips Industry</p> <p>邹广才 中国汽车芯片产业创新战略联盟副秘书长 Guangcai Zou, Vice Secretary General of China Automotive Chips Industry Innovation Alliance</p>
11:20-12:00	<p>圆桌：汽车芯片应用牵引探讨 Panel : Automotive Chip Application Traction Discussion</p> <p>主持人：任艳 工业和信息化部电子第五研究所元器件与材料研究部副主任 Moderator: Yan Ren, Deputy Director of Components and Materials Research Department, The Fifth Institute of Electronics, Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China</p> <p>嘉宾（排名不分先后）Guests(in no particular order)</p> <p>韦德领 东风日产乘用车公司技术中心副中心长 Deling Wei, Deputy Center Director of Dongfeng Nissan Passenger Vehicle Company Technology Center</p> <p>陈卓 惠州华阳通用电子有限公司首席技术官 Steven, Chief Technology Officer of Huizhou Foryou General Elections Co., Ltd</p> <p>周晓阳 广东芯聚能半导体有限公司总裁 Gilbert, Chief Executive Officer of Guang Dong Accopower Semiconductor Co., Ltd</p> <p>邹广才 中国汽车芯片产业创新战略联盟副秘书长 Guangcai Zou, Vice Secretary General of China Automotive Chips Industry Innovation Alliance</p> <p>刘国友 株洲中车时代电气股份有限公司新型功率半导体器件国家重点实验室常务副主任，中车科学家 Guoyou Liu, Executive Deputy Director & CRRC Scientist for State Key Laboratory of Advanced Power Semiconductor Devices of Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd</p> <p>沈宁 中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司 副总经理 Ning Shen, Vice General Manager of PICC Property and Casualty Company Limited of Guangdong Branch</p> <p>叶建斐 深圳中电港技术股份有限公司 副总经理 Antonio, Vice General Manager of China Electronics Corporation Port technology Co., Ltd</p>
12:00-12:05	幸运抽奖 Lucky Draw
12:05-13:00	午餐（仅限受邀参加）Lunch(Invited only)

*实际议程以当天为准 The actual agenda is subject to the current day



IC 制造生态发展论坛

Ic Manufacturing Industrial Eco-Development Symposium

2021 年 11 月 3 日星期三 08:30-16:45 广州黄埔君澜酒店 一楼黄埔 A 厅
Nov. 3rd, 2021 Wednesday 08:30-16:45 Huangpu Barllroom A, 1F, NARADA Hotel, Guangzhou

特别鸣谢/Sponsors:



主持人: 黄河 博士 中芯集成电路 (宁波) 有限公司首席执行官 Moderator: Herb Huang , Ph.D., CEO of Ningbo Semiconductor International Corporation	
时间/Time	演讲题目/Topic & 演讲人/Speaker
08:30-08:55	面向智能驾驶的车规级模拟芯片设计 Automotive Grade Analog Circuit Design For Intelligent Driving
	王云 大湾区集成电路与系统研究院常务副院长/中科院微电子所汽车中心主任 Yun WANG , Executive Vice-president of Guangdong Greater Bay Area Institute of Integrated Circuit and System, Director of R&D Center for Green Energy Automotive Electronics
08:55-09:20	复杂智能视觉技术助力半导体制造质量控制 Advanced intelligent vision technology enhances the quality control in semiconductor manufacturing process
	吴昌力 聚时科技 (上海) 有限公司研发总监 Changli WU , R&D Director of Matrixtime Robotics Co.,Ltd.
09:20-09:45	通过检测及晶圆几何形貌量测实现晶圆及集成电路生产的过程控制 Process Control for Wafer and IC manufacturing through Inspection and Wafer Geometry Metrology
	屈自豪 博士 科磊半导体设备设备技术 (上海) 有限公司 Zihao Qu , KLA Corporation
09:45-10:10	集成电路制造工艺中的关键参数控制 key parameter control in IC manufacturing process



	汪志勇 梅特勒-托利多 (上海) 国际贸易有限公司市场专家 Zhiyong WANG , Marketing Expert of METTLER TOLEDO
10:10-10:30	茶歇与展览交流 Networking Break
10:30-10:55	感知世界 – 先进的 3D 视觉 CIS 技术 Sensing the World - Advanced CMOS Image Sensor Technology for 3D Imaging and Beyond
	秦磊 Tower Semiconductor Ltd. 全球副总裁 Lei QIN , Vice President of China Operations, Tower Semiconductor Ltd.
10:55-11:20	晶圆车间物料配送自动化解决方案-移动操作机器人的应用 Wafer workshop material distribution automation solution-Application of Autonomous Mobile Robot
	邓栋梁 深圳优艾智合机器人有限公司 营销总监 Alan Deng , Marketing Director of Shenzhen Youibot Robotics Co.,Ltd.
11:20-11:45	智能化错误侦测与分类系统在半导体制造中的数据分析应用 The data analysis application in Semiconductor Manufacturing by Intelligent Fault Detection & Classification (iFDC)
	师伟堂 上海哥瑞利软件股份有限公司产品总监 Weitang Shi , Product Director of Shanghai Glorysoft Co., Ltd.
11:45-12:10	为芯片筑建家园 Building Home For CHIPS
	王丙信 中国电子系统工程第二建设有限公司高级副总经理 Bingxin Wang , Senior Vice President of China Electronics System Engineering No.2 Construction Co., Ltd.
12:10-12:15	幸运抽奖 Lucky Draw
12:15-13:30	自助午餐 Buffet Lunch
主持人: 徐伟 广东芯粤能半导体有限公司总经理 Moderator: Wei XU , General Manager of AscenPower Semiconductors Co., Ltd.	
13:30-13:55	三维晶圆级先进封装技术进展 Progress of 3D Wafer level advanced packaging technology
	马书英 华天科技(昆山)电子有限公司研究院院长 Dennies Ma , Huatian Technology (Kunshan) Electronics Co., Ltd.
13:55-14:20	武汉新芯先进特色工艺的发展与创新 The Development and Innovation of XMC's Advanced Specialty Technologies



	袁忠根 武汉新芯集成电路制造有限公司代工业务处市场总监 Tom Yuan, XMC
14:20-14:45	New Data Analytics Approach for Advanced Semiconductor IC Manufacturing 先进半导体 IC 制造的新型数据分析方法 黄钦州 科磊半导体设备技术（上海）有限公司产品营销总监 Kevin Huang, Director of Product Marketing in KLA Corporation
14:45-15:05	茶歇与展览交流 Networking Break
15:05-15:30	ASM 赋能先进技术 ASM enable advanced technologies 徐来 ASM 中国区总经理 LAI XU, General Manager of ASM China, Inc.
15:30-15:55	本土 IC 制造生态：有机成长回顾与对比浅析 Domestic IC Manufacturing Ecosystem: Historical and Comparative Review and Analysis on Organic Growth 黄河 博士 中芯集成电路（宁波）有限公司首席执行官 Herb Huang, Ph.D., CEO of Ningbo Semiconductor International Corporation
15:55-16:20	行业持续景气，国产设备材料厂商进入黄金发展期 The Industry Continues To Prosper, Domestic Equipment & Material Manufacturers Have Entered A Golden Period of Development 李双亮 兴业证券经济与金融研究院电子行业资深分析师 ShuangLiang Li, Electronics Industry Senior Analyst, Research Institute of Economics and Finance, China Industrial Securities.
16:20-16:45	芯片制程关键材料开发，助力半导体产业生态发展 Development of key materials for the chip manufacturing process to promote the ecological development of the semiconductor industry 刘志斌 博士 广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院芯片化学材料中心执行副主任，高级工程师 Zhibin Liu, Director/Senior Engineer of Executive Deputy Director of Chip Chemical Materials Center, HUANGPU INSTITUTE OF MATERIALS
16:45-16:55	幸运抽奖 Lucky Draw

*实际议程以当天为准 The actual agenda is subject to the current day



IC 设计与制造协同论坛

IC DESIGN AND MANUFACTURING COLLABORATION FORUM

2021 年 11 月 3 日星期三 09:00-11:50 广州黄埔君澜酒店 二楼香雪厅 A
Nov. 3rd, 2021 Wednesday 09:00-11:50 Xiangxue Barllroom A, 2F, NARADA Hotel, Guangzhou

特别鸣谢/Sponsors:  **SILVACO**

主持人: 俞少峰 复旦大学微电子学院教授 Moderator: Shaofeng YU , Professor of School of Microelectronics, Fudan University, Shanghai, China	
时间/Time	演讲题目/Topic & 演讲人/Speaker
09:00-09:10	致辞—— 张卫 复旦大学微电子学院院长 Address—— Wei ZHANG , Dean of School of Microelectronics, Fudan University, Shanghai, China
09:10-09:30	半导体先进制造技术与生态合作 Advanced semiconductor manufacturing technology and ecological cooperation
	魏琦 紫光展锐产品工程部部长 QI.WEI , Director of Product engineering department, UNISOC.
09:30-09:50	Calibre 机器学习平台助力芯片智能制造 Calibre machine learning platform enabling IC Smart Manufacturing
	李智峰 西门子 EDA 应用工程经理 Zhifeng Li , AE Manager, Siemens EDA
09:50-10:10	Silvaco TCAD 助力半导体制造和设计协同 From process/device to circuit/variation simulation with Silvaco TCAD
	常志强 Silvaco 中国 TCAD 技术支持经理 Kevin Chang , TCAD Manager Silvaco China
10:10-10:30	茶歇与展览交流 Networking Break
10:30-10:50	成熟领先 IP 帮助国产处理器从芯片走向解决方案 Proven leading IP enable domestic processors move from chips to solutions
	时昕 博士 Imagination 中国区战略市场及生态副总 Dr. Tim Shi , Imagination Technology
10:50-11:10	集成电路设计工艺协同优化流程和工具 DTCO work flow and EDA tools



	伍宏 墨研计算科学有限公司总经理 Hong Wu , CEO of Moyan Computational Science Co., Ltd.
11:10-11:30	后摩尔时代设计与制造的融合发展 Integrative development of design and manufacturing in the post-Moor era
	沈磊 中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长、上海市集成电路行业协会副会长、复旦大学研究生导师、上海复旦微电子集团股份有限公司总工程师 Shen Lei , Vice Chairman of China Semiconductor Industry Association IC Design Branch, Vice President of Shanghai IC Industry Association, Graduate Tutor of Fudan University, Chief Engineer of Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited.
11:30-11:50	落地 DTCO, 助力中国半导体产业 From Data to Design Signoff: An EDA Eco-system for DTCO enablement
	刘文超 概伦电子股份有限公司副总裁 Wenchao LIU , VP of Primarius Technologies Co., Ltd
11:50-13:30	自助午餐 Buffet Lunch

*实际议程以当天为准 The actual agenda is subject to the current day



功率及化合物半导体论坛

POWER & COMPOUND SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT SYMPOSIUM

2021 年 11 月 3 日星期三 09:00-16:45 广州黄埔君澜酒店 一楼开创厅
Nov. 3rd, 2021 Wednesday 09:00-16:45 Kaichuang Room, 1F, NARADA Hotel, Guangzhou

特别鸣谢/Sponsors:



主持人: 周贞宏 博士 福建省安芯投资管理有限责任公司管理合伙人兼首席战略官 Moderator: Zhenhong ZHOU , Managing Partner & Chief Strategy Officer, An Xin Capital Co. Ltd	
时间/Time	演讲题目/Topic & 演讲人/Speaker
09:00-09:25	SiC 功率模块在新能源汽车中的应用 The Application of SiC Power Modules in Electric Vehicles
	周晓阳 广东芯聚能半导体有限公司 CEO Gilbert ZHOU , CEO of Guangdong AccoPower Semiconductor Co.,Ltd.
09:25-09:50	低碳“芯”机遇——碳化硅功率器件技术和应用 The Technology and Application of SiC Power Device
	汪之涵 深圳基本半导体有限公司董事长 Zhihan Wang , Chairman of BASiC Semiconductor LTD.
09:50-10:15	舜宇仪器智能光学检测及技术展望 SOPTOP Intelligent Optical Inspection and Technology Prospect
	李涛 宁波舜宇仪器有限公司研发总监 James Li , R & D Director of Ningbo Sunny Instruments Co., Ltd.
10:15-10:35	茶歇与展览交流 Networking Break
10:35-11:00	面向快充应用的 GaN 材料和器件技术 Gan Materials and device technology for PD quick charger applications
	袁理 青岛聚能创芯微电子有限公司总经理 Li Yuan , General Manager of Qingdao Cohenius Microelectronics Co.,Ltd.
11:00-11:25	第三代半导体智能制造 The third generation of semiconductor intelligent manufacturing
	梁惠生 上扬软件(上海)有限公司技术总监



	Huisheng LIANG , Technical Director, FA Software (Shanghai) Co., Ltd.
11:25-11:50	利用结构创新赋能本土半导体产业链升级 Creating Values for China Semiconductor supply chain through innovation in workflow, infrastructure, and digital solutions
	曹潇潇 赛默飞世尔科技高级业务拓展经理 Xiaoxiao Cao , Senior Manager for Business Development, Material Structure Division, Thermo Fisher Scientific
11:50-11:55	幸运抽奖 Lucky Draw
11:55-13:30	自助午餐 Buffet Lunch
主持人: 周晓阳 广东芯聚能半导体有限公司 CEO Moderator: Gilbert ZHOU , CEO of Guangdong AccoPower Semiconductor Co.,Ltd.	
13:30-13:55	SiC 功率器件的技术发展, 机遇与挑战 The development, opportunities and challenges of SiC power devices
	邓旻熙 华润微电子有限公司 功率器件事业群高级经理 Minxi Deng , Senior Manager of China Resources Microelectronics Limited. PDBG
13:55-14:20	化合物半导体工艺设备解决方案 Equipment and Process Solutions in Compound Semiconductor
	牛群 北京北方华创微电子装备有限公司华南区办事处总经理 Qun Niu , General Manager of South China Office Beijing NAURA Microelectronics Equipment Co., Ltd.
14:20-14:45	原子层沉积技术在 GaN 功率半导体制造中的创新应用 Atomic Layer Deposition Enabling Innovation in GaN Power Semiconductor Manufacturing
	聂翔 青岛四方思锐智能技术有限公司总经理 Xiang NIE , General Manager, Qingdao Sifang SRI Intellectual Technology Co.Ltd
14:45-15:05	茶歇与展览交流 Networking Break
15:05-15:30	碳化硅在新能源汽车领域的应用及市场前景 Application and market prospects of silicon carbide in new energy vehicles
	陈东坡 北京三安光电有限公司副总经理 Dongpo Chen , Deputy General Manager of Beijing Sanan Optoelectronics Co., Ltd.
15:30-15:55	国产碳化硅突破的难点与机遇 Challenges and Opportunities of China Silicon Carbide Industry
	高远 泰科天润半导体技术(北京)有限公司应用测试中心主任 Gao Yuan , Director of Application and Testing Center of Global Power Technology Co.,



	Ltd., Inc.
15:55-16:20	功率器件先进微纳金属烧结封装技术 Advanced Micro-Nano Metallic Sintering Technology in Power Electronics Packaging 李俊 南方科技大学-天芯互联联合实验室副主任 Jun LI, Assistant Director of SUSTECH-SCI Advanced Package Technology Joint Lab
16:20-16:45	中国第三代半导体产业乘风破浪，扬帆起航 The advanced semiconductor industry in China, which braves waves and sail forward with resolve 朱航欧 爱集微咨询（厦门）有限公司集成电路产业高级分析师 Hangou Zhu, Senior Analyst of JW Insights (Xiamen) Co., Ltd.
16:45-16:55	幸运抽奖 Lucky Draw

*实际议程以当天为准 The actual agenda is subject to the current day



智能传感器专题论坛

INTELLIGENT SENSOR SYMPOSIUM

2021 年 11 月 3 日星期三 09:00-16:20 广州黄埔君澜酒店 一楼开源厅

Nov. 3rd, 2021 Wednesday 09:00-16:20 Kaiyuan Room, 1F, NARADA Hotel, Guangzhou

智能传感器主论坛 Main Forum Of Intelligent Sensor Symposium	
主持人: 杨潇 国家智能传感器创新中心董事长 Moderator: Xiao YANG , Chairman of National Intelligent Sensor Innovation Center	
时间/Time	演讲题目/Topic & 演讲人/Speaker
09:00-09:30	会议签到 Sign in
09:30-09:45	致辞 ——工信部领导、广东省领导 Addresses ——Leader from the Ministry of Industry and Information Technology、Leader from Guangdong Province
09:45-10:10	粤港澳大湾区集成电路及传感器产业建设的历史机遇 Historical Opportunities For The Construction Of Integrated Circuit And Sensor Industry In Great Bay Area
	于洪宇 南方科技大学深港微电子学院院长 Hongyu YU , Dean of Shenzhen Hong Kong School of microelectronics, Southern University of science and technology
10:10-10:35	上海工研院公共研发中试平台打破超越摩尔领域技术转移壁垒 SITRI's open R&D platform breaks down barriers to technology transfer in the field of More than Moore
	丁辉文 上海微技术工业研究院总经理 Mark Ding , SITRI CEO
10:35-11:00	先进传感器产业生态建设 Ecological construction of advanced sensor industry
	张文燕 国家智能传感器创新中心 副总裁 Wenyan Zhang , Vice-president of National Intelligent Sensor Innovation Center
11:00-11:25	消费类传感器技术发展方向 Development Direction of Consumer Sensor Technology
	潘政民 瑞声科技控股有限公司行政总裁兼执行董事 Zhengmin PAN , CEO and Executive director of AAC Technologies
11:25-11:50	MEMS 滤波器的研发与产业化 R&D and Industrialization of MEMS filters



	<p>杨云春 北京赛微电子股份有限公司董事长 Yunchun Yang, Chairman of Sai MicroElectronics Inc.</p>
11:50-12:15	<p>智能传感器的 IDM 模式 IDM model for Smart Sensors</p>
	<p>张宾 广州奥松电子股份有限公司 董事长 Bin Zhang, Chairman of Aosong Electronic Co., LTD</p>
12:15-14:00	自助午餐 Buffet Lunch
<p>传感器应用论坛 Sensor Application Forum</p>	
<p>主持人: 丁辉文 上海微技术工业研究院总经理 Mark Ding, SITRI CEO</p>	
14:00-14:25	<p>中国 MEMS-IDM 发展之路 The Road of Development of Chinese MEMS-IDM</p>
	<p>胡铁刚 杭州士兰微电子股份有限公司副总经理 Tiger Hu, The Vice President of SILAN Microelectronics Co. , LTD</p>
14:25-14:50	<p>全屋智能时代智能传感器的机遇与挑战 Opportunity and Challenges of Smart Sensor in the Era of Smart Home</p>
	<p>马建良 美的集团中央研究院感知技术研究所所长 Jalen Ma, Director of Intelligent Perception Institute Midea Corporate Research Center</p>
14:50-15:15	<p>医用传感器应用及趋势 Application and Trend of Medical Transducers</p>
	<p>岑建 迈瑞医疗生命信息与支持事业部总经理, Jian Cen, General Manager, Patient Monitoring and Life Support Division, Mindray.</p>
15:15-15:30	茶歇与展览交流 Networking Break
15:30-15:55	<p>车规级传感器应用 The sensor application for automotive level</p>
	<p>方骏 上海矽睿科技副总裁 Fang jun, shanghai QST VP</p>
15:55-16:20	<p>CMOS-MEMS 智能微流控及其应用 CMOS-MEMS Microfluidics and Its Applications</p>
	<p>关一民 上海傲睿科技有限公司董事长 Yimin GUAN, Chairman and CEO, Shanghai Aurefluidics Technology</p>

*实际议程以当天为准 The actual agenda is subject to the current day



2021 中国半导体材料创新发展大会

2021 CHINA SEMICONDUCTOR MATERIALS INNOVATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE

2021 年 11 月 3 日星期三 09:00-11:50 广州黄埔君澜酒店 一楼黄埔 B 厅
Nov. 3rd, 2021 Wednesday 09:00-11:50 Huangpu Ballroom B, 1F, NARADA Hotel, Guangzhou

特别鸣谢 /Sponsors:



安集微电子科技(上海)股份有限公司
ANJI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.



PhiChem · 飞凯材料
股票代码: 300398



09:00-09:25	IC 材料奖颁奖礼 IC Award Ceremony
	主持人: 石瑛 ICMtia 常务副理事长兼秘书长 Host: Ying Shi, Executive Vice Chairman & Secretary General, ICMtia
主旨报告 Keynote Speech	
主持人: 王淑敏 博士 安集微电子科技(上海)股份有限公司董事长兼总经理 & 姚力军 博士 宁波江丰电子材料股份有限公司董事长兼首席技术官 Host: Dr. Shuming Wang, Chairman and General Manager, Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. & Dr. Lijun Yao, Chairman and Chief Technology Officer, Konfoong Materials International Co., Ltd.	
09:30-09:50	先进封装与其材料的要求 Advanced Packaging and Its Material Requirements
	郑子企 博士 通富微电子股份有限公司先进封装 CTO Dr. Key. Chung, Advanced Package CTO, TongFu Microelectronics Co., Ltd
09:50-10:10	技术大融合时代 – 重塑半导体和电子科技发展格局 Reinventing Electronics in the Era of Disruptive Convergence
	安高博 默克中国总裁 默克电子科技中国区董事总经理 Allan Gabor, President, Merck China, Managing Director of Electronics China
10:10-10:30	集成电路用电子气体的现状和发展预期 Current Status and Development Expectation of Electronic Gas Used in Integrated Circuits
	李俊华 博士 中船重工(邯郸)派瑞特种气体有限公司董事长 Dr. Junhua Li, Chairman, PERIC Special Gases Co., Ltd



10:30-10:50	CMP 的艺术, 纳米界面的材料工程科学原理 Art of CMP, Scientific Principles of Materials Engineering at the Nano Scale Interface
	王雨春 博士 安集微电子科技(上海)股份有限公司副总裁 Dr. Yuchun Wang , Vice President, Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd.
10:50-11:10	ArF 光刻胶产品开发和产业化进展 ArF Photoresist Product Development and Industrialization Progress
	毛智彪 博士 宁波南大光电材料有限公司副总经理 Dr. Zhibiao Mao , Vice President, Ningbo Nata Opto-Electronic Materials Co., Ltd
11:10-11:30	半导体材料市场的发展前景、挑战和新兴机遇 Semiconductor Materials Outlook, Challenges, and Emerging Opportunities
	Dan P. Tracy 博士 TECHCET 高级市场分析师 Dr. Dan P. Tracy , Sr. Director and Sr. Market Analyst, TECHCET
11:30-11:50	中国集成电路制造材料产业现状及发展态势 The Status and Development Tendency of China IC Manufacturing Material Industry
	石瑛 ICMtia 常务副理事长兼秘书长 Ying Shi , Executive Vice Chairman & Secretary General, ICMtia
12:00-13:00	自助午餐 Buffet Lunch

*实际议程以当天为准 The actual agenda is subject to the current day



半导体产业投资合作论坛

SEMICONDUCTOR INVESTMENT & COOPERATION SYMPOSIUM

2021 年 11 月 3 日星期三 13:30-17:45 广州黄埔君澜酒店 一楼黄埔 B 厅
Nov. 3rd, 2021 Wednesday 13:30-17:45 Huangpu Barllroom B, 1F, NARADA Hotel, Guangzhou



特别鸣谢 Sponsors:

<p>主持人: Polly Peng 博士 华登国际 董事总经理 Moderator: Dr. Polly Peng, MD & Partner of Walden International</p>	
13:30-13:50	<p>开场致词 Opening address 特邀嘉宾致词 Invited address</p>
	<p>金圣宏 粤财控股 董事长 Jin Shenghong, Chairman of Utrust Group 卢一先 广州市常委、南沙区委书记 Lu Yixian, Official of Guangzhou, Nansha District Party Secretary</p>
13:50-14:10	<p>历史的机会, 高科技的春天 Historic Opportunity, High Tech Spring is coming</p>
	<p>黄庆 华登国际 董事总经理、中国半导体行业协会 IC 设计分会副理事长 Hing Wong, MD of Walden International, Vice General Director of CSIA-ICCAD</p>
14:10-14:40	<p>半导体产业链投资热点 IC Industry Chain Investment hotspot</p>
	<p>王新潮 中国半导体行业协会封测分会名誉理事长、国家封测产业链技术创新战略联盟理事长 Wang Xinchao, Honorary General Director of CSIA-Packaging & Testing Branch, General Director of China Packaging & Testing Industry Chain Technology Innovation Strategy Alliance</p>
14:40-15:10	<p>全球半导体市场预测与中国半导体发展动力 Global Semiconductor Market Forecast and Key Driving Forces for China Chip Industry</p>
	<p>盛陵海 Gartner 副总裁 Roger Sheng, VP of Gartner</p>
15:10-15:30	<p>茶歇与展览交流 Networking Break</p>
15:30-16:30	<p>圆桌 A: “缺芯时代”半导体制造业投资探讨 Panel A: In Lack of IC Era, Semiconductor Manufacturing Industry Investment</p>



	<p>Discussion</p> <p>主持人: 黄庆 华登国际 董事总经理 Moderator: Hing Wong, MD of Walden International 嘉宾 (排名不分先后) Guests(in no particular order) 尹志尧 中微公司 董事长兼总裁 Gerald Yin, Chairman of AMEC 王海滨 广州国发 董事长 Wang Haibin, Chairman of GOFAR 杜洋 芯鑫租赁 董事长兼总裁 Du Yang, Chairman & CEO of Sino-IC Leasing 袁锋 广汽资本 总经理 Yuan Feng, GM of GAC-Capital 孙玉望 中芯聚源 总裁 Sun Yuwang, CEO of China Fortune-Tech Capital 陈伟 矽力杰半导体 董事长 Issac Chen, Chairman of Silergy</p>
16:30-16:45	<p>中国半导体设备材料投资数据分析 Investment Analysis Report of China Semiconductor equipment and materials</p> <p>赵占祥 云岫资本合伙人兼 CTO Adam Zhao, Partner & CTO of Winsoul Capital</p>
16:45-17:45	<p>圆桌 B: 深耕广东, 共同打造半导体产业第三极 Panel B: Deeply Root in Guangdong, Co-Building Semiconductor Industry Third Pole</p> <p>主持人: 王林 华登国际 合伙人 Moderator: Wang Lin, Partner of Walden International 嘉宾 (排名不分先后) Guests(in no particular order) 居龙 SEMI 中国区总裁 Lung Chu, China President of SEMI 李海明 粤芯半导体 市场副总裁 Haiming Chen, Vice President of CanSemi Tech 张琤 光控母基金 董事总经理 Zhang Cheng, MD of Everbright FOF 熊泉 武岳峰科创 合伙人 Peter Xiong, Partner of SummitView Capital 王淑敏 安集科技 董事长兼总经理 Wang Shumin, Chairman & CEO of Anji Micro 胡胜发 安凯微电子 董事长 Norman Hu, Chairman & CEO of AnyKa</p>
17:45—18:00	会议总结 Summary

*实际议程以当天为准 The actual agenda is subject to the current day



集成电路质量提升论坛

High-quality Development in Integrated Circuits Forum

2021 年 11 月 3 日星期三 09:00-12:00 广州黄埔君澜酒店 一楼黄埔 C 厅

Nov. 3rd, 2021 Wednesday 09:00-12:00 Huangpu Ballroom C, 1F, NARADA Hotel, Guangzhou

主持人: 王小强 工业和信息化部电子第五研究所元器件检测中心副主任 Moderator: Mr. Xiaoqiang Wang , Vice-Director of the Test Center of Electronic Components of China Electronic Product Reliability and Environmental Test Research Institute	
时间/Time	演讲题目/Topic & 演讲人/Speaker
09:00-09:05	领导致辞 Opening Ceremony
	工信部科技司/电子司领导 Leadership Speech
主题演讲 Keynote Speech	
09:05-09:25	《国产化替代整体解决方案助推集成电路高质量发展》 《High-Quality Development of Integrated Circuits by Total Solution for Domestic》
	罗道军 工业和信息化部电子第五研究所元器件检测中心主任 Daojun Luo , Director of the Test Center of Electronic Components of China Electronic Product Reliability and Environmental Test Research Institute.
09:25-09:45	《产品全生命周期质量管控》 《Quality Control of the Life Cycle of Products》
	沈磊 中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长、上海市集成电路行业协会副会长、复旦大学研究生导师、上海复旦微电子集团股份有限公司总工程师 Shen Lei , Vice Chairman of China Semiconductor Industry Association IC Design Branch, Vice President of Shanghai IC Industry Association, Graduate Tutor of Fudan University, Chief Engineer of Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited.
09:45-10:05	《加强企业质量基础设施 (EQI) 建设, 支撑我国电力集成电路产业高质量发展》 《Strengthen the construction of enterprise quality infrastructure to support the high-quality development of China's IC industry》
	王东山 国网信通产业集团北京智芯微电子科技有限公司资深技术专家 Dongshan Wang , Senior Technology Expert of the State Grid Communications Industry Group Beijing Smart Chip Microelectronics Technology Co., Ltd.
10:05-10:20	茶歇&抽奖环节 Tea Break& Lottery Activity
10:20-10:40	《用“芯”管理, 质量长存》



	《Managing With Heart, for Lasting Memory》
	何谊 长江存储科技有限责任公司副总裁 Dr. Yi He , Vice President of Yangtze Memory Technologies Co., Ltd
10:40-11:00	《功率半导体质量与可靠性》 《Quality and Reliability of Power Semiconductor Devices》
	任亚东 株洲中车时代半导体有限公司 研发中心主任助理 Yadong Ren , Assistant director of R & D Center of CRRC ELECTRIC VEHICLE Co., Ltd
11:00-11:20	《国产光耦芯片质量提升及高端光耦芯片国产替代》 《The Operation Quality of Optocoupler in China and Domestic Replacement of High-end Optocoupler Chip》
	陈益群 宁波群芯微电子有限责任公司执行董事兼总经理 Yiqun Chen , Executive Director and General Manager of NingBoQunXin Microelectronics Co., Ltd
	圆桌论坛——从“芯”出发，国产集成电路自主自强之路 Roundtable Forum——Self-reliance and Self-improvement in Integrated Circuits
11:20-12:00	主持人： 罗道军 工业和信息化部电子第五研究所元器件检测中心主任 Host: Mr. Daojun Luo , Director of the Test Center of Electronic Components of China Electronic Product Reliability and Environmental Test Research Institute. 圆桌嘉宾（拟）： guests: 张 宾 广州奥松电子有限公司董事长 Mr. Bin Zhang , Chairman of Guangzhou Ausong Electronic Co., Ltd 刘 凯 美的集团美仁半导体公司总经理 Mr. Kai Liu , General Manager of MR SEMI Co., Ltd 蔡述庭 广东工业大学微电子学院副院长 Dr. Tingshu Cai , Deputy Head the School of Microelectronics of Guangdong University of Technology 赵 斌 粤芯技术市场副总裁 Mr. Bin Zhao , VP of technology market of CANSEMI Technology Co., Ltd 熊振武 珠海全志科技股份有限公司质量总监 Mr. Zhenwu Xiong , Quality Director of Allwinner Technology Co., Ltd 刘 雄 深圳市紫光同创电子有限公司质量总监 Mr. Xiong Liu , Quality Director of SHENZHEN PANGO MICROSYSTEMS CO.,LTD.
12:00-13:30	自助午餐 Buffet Lunch

*实际议程以当天为准 The actual agenda is subject to the current day



集成电路检测与测试创新论坛

IC Inspection And Testing Innovation Forum

2021 年 11 月 3 日星期三 14:00-17:00 广州黄埔君澜酒店 一楼黄埔厅 C 厅

Nov. 3rd, 2021 Wednesday 14:00-17:00 Huangpu Ballroom C, 1F, NARADA Hotel, Guangzhou

论坛主题：芯测试 新挑战 “测”马扬鞭 开启检测新征程 Theme: New Challenge, New Journey	
14:00-14:20	领导致词 Addresses
	<p>叶甜春 中国半导体行业协会集成电路分会理事长、国家科技重大专项 02 专项技术总师、中国集成电路创新联盟副理事长兼秘书长 Tianchun YE, President of Academy of Integrated circuit, Chinese Academy of Sciences; Head of Overall Panel of National Science and Technology Major Projects (02); Vice President of China Semiconductor Industry Association</p> <p>雷瑾亮 检测&测试联盟副理事长/02 专项总体专家组 Jinliang LEI, Vice chairman of China IC Inspection and Testing Alliance/02 Project Expert</p>
14:20-14:35	集成电路检测和测试技术产品白皮书发布 Integrated Circuit Inspection And Test Technology Product White Paper Release
	<p>孙鹏 检测&测试联盟副秘书长 Peng SUN, Under Secretary General Of China IC Inspection and Testing Alliance</p>
14:35-14:55	茶歇与展览交流 Networking Break
论坛主旨报告 Keynote Speech	
<p>主持人：陆坚 中国电科第 58 所检测事业部总经理、检测&测试联盟副秘书长 Moerator: Jian LU, General Manager Of The 58th Research Institute Of China Electronics Technology Corporation & Secretary General Of China IC Inspection and Testing Alliance</p>	
14:55-15:20	中国集成电路测试业发展展望 China IC Test industry has bright future
	<p>肖志强 中国电科第 58 所副所长 Zhiqiang Xiao, Deputy director of the 58th Research Institute of China Electronics Technology Corporation</p>
15:20-15:45	高精度 ADC 测试技术 Test Techniques of High-precision ADC
	<p>戴志坚 电子科技大学高等研究院集成电路测试技术实验室主任 Zhijian Dai, IC Test Lab director of Higher Research Institute (shenzhen) of University of Electronic Science and technology of China</p>



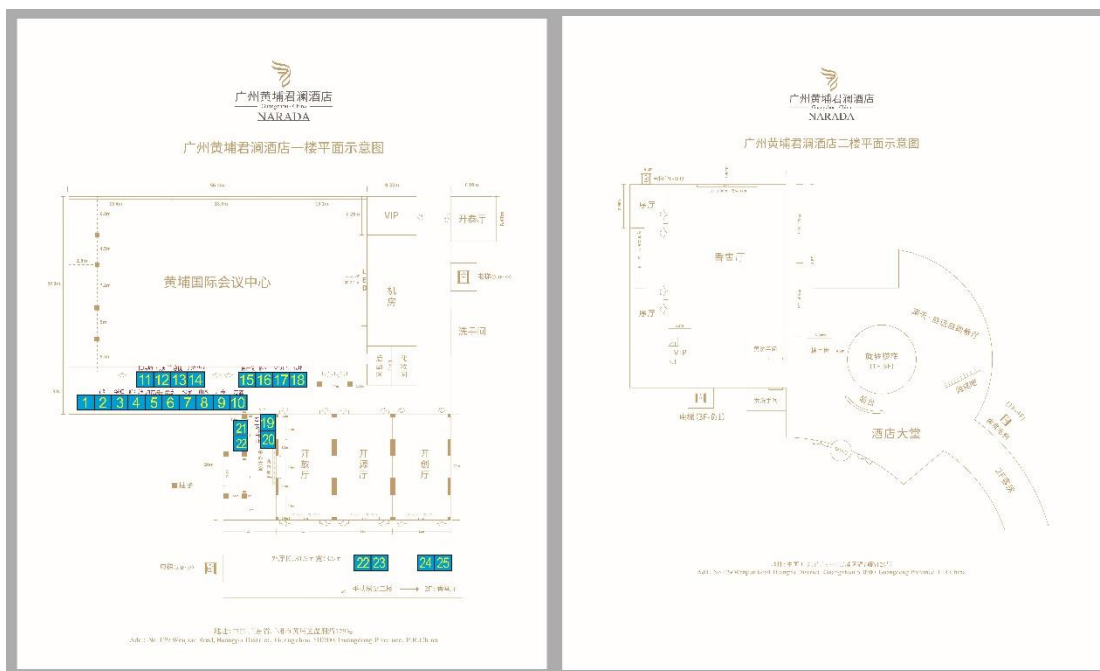
15:45-16:10	射频测试技术的演变、落地和未来 Evolution, localization and future of RF testing technology
	唐亮 砺铸智能设备（天津）有限公司总经理、唐明盛试科技（嘉善）有限公司董事长 Liang Tang , CEO of MIT Semiconductor (Tianjin) Co., Ltd., Chairman of TMSS Technology (Jiashan) Co., Ltd.
16:10-16:35	CPU 的测试挑战及应对策略 The Challenge of CPU Benchmark and Coping Strategy
	郭御风 飞腾公司副总经理、南开大学教授 Yufeng Guo , Vice President of Phytium Information Technology Co. LTD., Professor and Researcher at NanKai University
16:35-17:00	宽波段等离子光学晶圆检测对缺陷发现及监控的应用 Broadband Plasma Optical Wafer Inspection for DefDiscovery and Monitoring
	华波 美国 KLA 公司产品市场经理 Bo HUA , Product Marketing Manager in KLA

*实际议程以当天为准 The actual agenda is subject to the current day



展览展示 & 参展企业

CONFERENCE EXHIBITION



华虹集团
HUAHONG GROUP

华虹集团是中国目前拥有先进芯片制造主流工艺技术的8+12寸芯片制造企业。集团旗下业务包括集成电路研发制造、电子元器件分销、智能化系统应用等板块，其中芯片制造核心业务分布在浦东金桥、张江、康桥和江苏无锡四个基地，目前运营3条8英寸生产线、3条12英寸生产线。量产工艺制程覆盖1微米至28纳米各节点。二十多年来，集团在致力于发展自主可控集成电路产业的征程上取得了多个行业第一和唯一：率先建成了中国大陆第一条8英寸集成电路生产线，建设了本土企业第一条全自动的12英寸生产线；具有唯一一家国家级集成电路研发中心；成为业界第一家，也是唯一一家，连续两年建设并投产运营两条12英寸生产线的企业。集团现有员工10000余人，已形成一支专业化、国际化、高科技人才队伍。全集团累计专利申请受理超过14000件，超过95%为发明专利，获授权超过7000件。



深圳市凯尔迪光电科技有限公司
Shenzhen KED Optical Electric Technology Co.,Ltd.

深圳市凯尔迪光电科技有限公司成立于 2007 年，本公司专业生产气动钢网清洗机、夹具清洗机、PCBA 清洗机、离线 PCBA 清洗机、在线清洗机等设备,并提供成套自动化控制解决方案的高新技术企业，在香港、深圳、苏州、北京、上海等地均设立生产研发中心及办事处，拥有一流的跨国自动化研发团队和自主知识产权。2017 年凯尔迪加大半导体封装清洗市场的道路”的经营理念 and 员工一起进步，针对国内外市场需求，大力开发洗设备标准机和自动化设备等产品与市场。凯尔迪以良好的技术及产品，以及完善的售前、售中、售后服务，真诚期待着与您共创辉煌！



展示产品

AC-7000 全自动在线清洗机，适用于高产能的半导体(BGA、flip-chip、SIP 等封装器件)等产品的助焊剂残留清洗，另有多种选项功能满足用户优化工艺和控制成本的要求。该产品已经稳定用于半导体等高可靠性产品的日常清洗，AC-7000 在线式清洗机拥有核心技术，俱有更强的清洗能力！



HEIDENHAIN
海德汉

约翰内斯·海德汉博士（中国）有限公司

DR. JOHANNES HEIDENHAIN (CHINA) Co., Ltd.

德国海德汉公司是一家研发和制造光栅尺，角度、旋转编码器，长度计，数控系统，测头和数显表等的专业公司。产品遍布全球，具有广泛的应用领域，包括机床行业、自动化设备制造行业、半导体和电子器件设备制造业、航空航天、纺织和印刷机械以及电梯等行业。海德汉公司历年来都非常重视中国市场，为了更好地为中国广大的客户提供优质的服务，德国海德汉公司在 2001 年成立了中国的子公司。依托海德汉公司一百多年深厚的产业积淀，以及精湛的技术和丰实的管理经验，使得我们从成立伊始就能为中国市场提供优质的海德汉产品以及完善的服务。一流的技术、产品和服务使得海德汉在中国市场的业务发展非常迅速，目前我们的客户已经遍及全国工业、科研和教育等许多不同的领域。海德汉的全体中国员工将秉承海德汉的宗旨：为客户提供最优质的服务、品质最优良的产品并不断完善自己。我们坚信我们必定能成为广大客户在发展各自事业过程中最紧密的伙伴。

展示产品

海德汉和 RSF 敞开式光栅尺，设计用于对测量精度要求极高的系统，典型应用包括：半导体业的测量和生产设备、PCB 电路板组装机、超高精度机床、高精度机床、测量机和比较仪，测量显微镜和其它精密测量设备、直驱电机。ETEL 运动平台系统和控制卡驱动器：作为全球领先的直接驱动技术供应商，为用户提供最先进、高度可靠及专注于运动控制的产品而享誉业界。得益于磁体设计、轴承技术、计量技术、运动控制架构、仿真工具以及材料的多领域竞争优势，ETEL 是先进机械电子解决方案的理想供应商。ETEL 提供丰富的运动系统，从标准的单件产品到高度集成的平台产品。这些产品能满足半导体和电子行业应用的最严格要求，让机器制造商能专注于他们的核心技术。

复享 让光谱简单 上海复享光学股份有限公司

上海复享光学股份有限公司是中国先进的光谱设备制造商。公司致力于在多种环境下满足客户日益复杂的需求：在科研创新领域，为客户提供高品质的光谱仪及定制系统；在半导体领域，通过深度光谱技术，解决芯片制造过程中的等离子体刻蚀终点检测、缺陷检测、光学量测、晶圆级分选和最终光电性能检测等问题。公司历时十年发展，高度重视自主研发，着力于光子学与人工智能的融合，已成为一家算法驱动的光谱硬科技公司。让光谱简单，是我们每天的使命与追求。



宁波舜宇仪器有限公司

舜宇显微系统

NINGBO SUNNY INSTRUMENTS CO.,LTD

宁波舜宇仪器有限公司是重点高新技术企业，亦是首家在香港联交所主板上市的国内光学企业——舜宇光学科技集团有限公司的核心企业之一。公司主要从事数码化、自动化、智能化光学检测设备的研发、制造、营销和服务，产品广泛应用于高校互动教学、科研金相分析、半导体硅晶片检测、地质矿物分析、精密工程测量等领域，并与德国 ZEISS、日本 OLYMPUS 等国际知名企业保持长期的合作关系。



展示产品

- 1、MS 测量显微镜：结合了金相显微镜的高倍观察能力，和影像测量仪的 X、Y、Z 轴表面尺寸测量功能，具备明暗场、微分干涉、偏光等多种观察功能。可广泛应用于半导体、PCB、LCD、手机产业链、光通讯、基础电子、模具五金、医疗器械、汽车行业、计量行业等领域的检测；
- 2、AWL 晶圆搬运系统: SOPTOP AWL 系列晶圆检查系统，兼具稳定性和安全性，能够安全可靠的传送晶圆，适合于前道到后道工程的晶圆检查。



深圳市山木电子有限公司 ShenZhen Sam Electronic Equipment Co.,Ltd

深圳市山木电子有限公司成立于 2005 年，是一家致力于 SMT 清洗设备（PCB/PCBA/钢网/治具/刮刀/吸嘴/IC 载板/CMOS/半导体器件）、半导体清洗设备、废水处理设备、激光应用设备研发、制造、销售的国家高新技术企业，SAM 将不断地推新和细化产品，使产品和技术达到世界级制造业水平，以满足广大客户的高端需求。经过十几年的发展，山木雄厚的技术实力和卓越的服务赢得了广大业界的信赖支持，公司产品连续五年荣获中国 SMT 创新成果奖；山木自主研发的 SMT 清洗设备、半导体清洗设备等取得发明或实用新型专利证书。我司产品被富士康、伟创力、比亚迪、博世、中国兵器、中国电科集团、中国航天集团、中国电子集团、华为、环旭电子、赛意法半导体、长电半导体、京东方等知名企业所认可和大量使用，并远销新加坡、马来西亚、泰国、美国和欧洲等国家和地区。

展示产品

SM-6700 在线封装基板清洗机



芯鑫租赁 芯鑫融资租赁有限责任公司 SINO IC LEASING SINO IC LEASING Co., Ltd.

芯鑫融资租赁有限责任公司（简称“芯鑫租赁”）于 2015 年 8 月 27 日在上海自贸区注册成立，是国内目前唯一专注于集成电路产业的融资租赁公司。公司由国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）牵头发起，股东单位由中芯国际、清华紫光、长电科技等半导体产业龙头，浙江、深圳、湖南、河南、北京、上海、西安、青岛等产业聚集区地方国资以及专业投资机构强强联合组成，具有较强的产业和金融资源整合优势。目前注册资本 132.09 亿元，位居全国融资租赁公司前三。自成立以来，芯鑫租赁始终坚守服务产业发展的初心，按照《国家集成电路产业发展推进纲要》谋划的方向，与大基金紧密协同，结合产业特点和客户需求，努力发挥租赁业务优势，积极探索创新金融服务，在集成电路、半导体、战略新兴产业等多个板块积累了较为丰富的服务经验。截至 2020 年末，公司总资产规模近 500 亿元，累计实现投放 1028 亿元，70%以上投向集成电路及半导体领域。展望未来，芯鑫租赁将继续“不忘初心，牢记使命”，在大基金的坚强引领和政府、产业、各金融机构等合作方的大力支持下，致力于为产业链各环节客户提供更为专业、优质、多元化的综合性金融服务。



SUNCAST

日东智能装备科技（深圳）有限公司

日东科技

Suneast Intelligent Equipment Technology (Shenzhen) Co.Ltd

日东科技 1984 年成立于香港，1999 年在深圳建立工业园，2000 年在香港上市（股票代码 0365.HK），为芯成科技控股旗下核心企业。日东科技配备了现代化的产业园和先进的研发实验设施，具有雄厚的研发、设计、生产、自动化、信息化装备制造的系统集成能力，销售网络遍布全球。与清华大学、香港中文大学、香港科技大学、哈尔滨工业大学达成技术战略合作，研发实力达到国内外先进水平。在粤港澳大湾区的核心地带，日东科技已服务半导体后端应用客户超过三十五年，公司的下游及终端客户包括华为、中兴、TCL、海康威视、木林森、光弘、德赛、兆驰、聚飞等。公司自主研发的“选择性波峰焊焊头”比同行业厂商的使用寿命多出一倍；“SMT 模块”不断提升产线模块拼装的灵活性；“龙门双驱同步跟随直线电机”已成功应用到多个高速、高精度的装备制造和加工领域，得到用户的广泛赞誉。新推出焊线机、固晶机等半导体封装设备，是日东科技的又一匠心力作，助力国产芯片产业发展壮大。如今，日东科技已成为中国智能装备行业的领导者。作为芯成科技控股的核心企业，日东科技将坚定集团的战略目标，打造成为高科技领域的世界级一流企业。

展示产品

半导体全程充氮回流焊

产品特点：

- 1、高产能，低能耗，最新隔热技术，全新炉膛设计，控温能力强，精度高；
- 2、最新冷却技术，底部冷却系统能够可靠、高效地冷却复杂 PCB 板，降低组件应力影响；
- 3、设备全程充氮，配置高精度氧分仪，具备温度实时监控功能；
- 4、炉膛助焊剂回收采用多级过滤，带独立回收箱；
- 5、闭环气体循环，有效节省耗氮量，降低氧含量；
- 6、设备可以应用于高洁净度的环境中；

梅特勒-托利多

梅特勒-托利多是行业领先的精密仪器及衡器制造商与服务提供商，产品应用于实验室、制造商和零售服务业。梅特勒-托利多提供贯穿客户价值链的称重、分析和产品检测解决方案，帮助客户简化流程、提高生产率、确保产品符合法律法规要求以及优化成本。梅特勒-托利多在中国的上海、常州和成都都设有运营中心、制造基地及研发中心，并拥有遍布全国的销售及服务网络。



青岛四方思锐智能技术有限公司

思锐智能

Qingdao Sifang SRI Intellectual Technology Co., Ltd

青岛四方思锐智能技术有限公司，是对标国家战略性新兴产业发展方向，面向“半导体装备”和“新型显示”等关键核心技术的智能科技公司。2018 年 9 月，思锐智能完成了对芬兰 Beneq Oy 100% 股权的收购工作。主营业务包括两大板块：原子层沉积镀膜（ALD）设备和薄膜电致发光显示屏（EL）。思锐智能以 Beneq 为海外技术研发中心，逐步开展 ALD 技术和 EL 技术研发与产业化落地，通过整合 Beneq 近 40 年成熟应用的 ALD 镀膜技术与国内产业化优势，聚焦集成电路、新兴半导体、泛半导体和光电子等工业镀膜应用领域，为全球客户提供成熟领先的 ALD 镀膜解决方案，助力半导体等相关行业发展。



展示产品

思锐智能旗下的 Beneq®被誉为原子层沉积 ALD 技术的发源地，致力于提供各种镀膜设备产品和研发服务。Beneq Transform 设备为超摩尔应用市场提供了具有竞争力的 ALD 解决方案。其采用全新的集群设计，兼容单片，批量，热法及等离子体增强 ALD 工艺模块，可满足特定的晶圆产能要求，也可应对不断增长的产量或新的 ALD 应用而进行升级。工业标准水平晶圆装载自动化，将产能提升到一个全新的水平。符合 SEMI S2/S8 认证和 SECS/GEM 标准。应用领域：功率器件，CMOS 图像传感器，光电子，Micro-LED & OLED，RF，GaAs/GaN/InP RF ICs，3D MEMS，芯片级封装等。Beneq P 系列工具是专为工业规模生产设计的原子层沉积系统。这些大容量反应器，是从研发阶段到大规模工业化生产的理想工具。P 系列设备都带有定制反应腔的配置选项，可用于各种基底。而且反应腔易于更换，保证正常运行时间，最大限度地减少因维护而造成的停机时间。P 系列工具在薄膜均匀性、批量大小和沉积速率等方面进行了优化。应用领域：半导体设备零部件镀膜，光学镀膜，OLED 和电子器件的防潮镀膜等。Beneq C2R，首次将等离子体增强型 ALD (PEALD) 工艺应用于大批量生产。由于采用了旋转 PEALD 工艺，其沉积的薄膜厚度可达到几个微米。Beneq C2R 是可集群工具，在选择高沉积速率、低成本、低工艺温度及最佳薄膜质量的 ALD 设备时，Beneq C2R 是理想之选。

NAURA 北京北方华创微电子装备有限公司 北方华创 Beijing NAURA Microelectronics Equipment Co., Ltd.

北京北方华创微电子装备有限公司（002371.SZ 简称：北方华创）成立于 2001 年。经过二十年的发展，北方华创已成为国内领先的半导体装备制造与服务商。北方华创的主要产品包括刻蚀机、PVD、ALD、CVD、氧化/扩散炉、清洗机、气体质量流量计等高端半导体工艺装备及核心零部件，广泛应用于集成电路、先进封装、半导体照明、微机电系统、功率半导体、化合物半导体、新能源光伏、平板显示等领域，为半导体、新能源、新材料等领域提供解决方案。公司拥有四大产业制造基地，分别位于北京经济技术开发区、北京平谷马坊工业园区、北京顺义天竺出口加工区和美国宾夕法尼亚，服务体系覆盖欧、美、亚主要国家和地区。北方华创始终秉承以客户需求为导向持续创新的理念，以“精良品质·卓越服务·中国制造”为企业宗旨，致力于引领半导体产业发展，与全球合作伙伴携手，带给产业无限可能！

展示产品

十大领域设备及工艺解决方案（集成电路；功率半导体；先进封装；半导体照明；新能源光伏；化合物半导体；衬底材料；硅基微型显示；科研；平板显示）
气体质量流量控制器



广东金仕伦清洗技术有限公司 GUANGDONG NEP CLEANING TECHNOLOGY CO., LTD

广东金仕伦清洗技术有限公司成立于 2007 年，是一家专注于电子行业精密清洗设备研发、生产、销售及工艺方案提供商，国家级高新技术企业。经过 10 多年发展，公司已成为电子行业的精密清洗方案领军企业，旗下设有 10 余家办事处，业务遍布整个亚洲及欧洲，在国内外客户中享有良好的声誉。广东金仕伦公司将秉承“不断创新、追求质量、精益求精”的理念，与时俱进的技术、国际认证的质量、开拓进取的精神，为客户提供高质量的自动化清洗设备和服务。



展示产品

在线清洗机:

该设备是一款全自动在线式清洗机,适用于高产能的 SIP、WLP、PLP、FCCSP/BGA、Ball Mount、IGBT、Lead frame 等封装形式的半导体器件 Molding 前的助焊剂残留、有机、无机污染物的清洗。该设备对 CPU、RF、MEMS、Memory、Power、Cmos、Mini-LED 等半导体器件的精密清洗有着卓越的清洗能力和稳定性。

气相双溶剂清洗机:

该设备主要用于清洗精密机械零件、微组装模块、混合集成电路、Lead frame、SMT-PCBA 板焊接后焊料残留的各种助焊剂、油污的清洗。清洗后表面清洁干净,无助焊剂、油污等污染物残留。宽泛的工艺窗口,适应多种清洗剂的搭配使用,良好的材料兼容性,绝佳的清洗效果保证。对器件的铜,银,铝等活跃金属不会造成二次氧化的可能。

FOUP 清洗机:

该设备是一种自动的离心清洗机,适用于所有类型的晶圆料盒 (Smif Foup、Fosb、Cassette),可以实现高精度的清洗和干燥效果。在 Chamber 的花篮上安装和固定待清洗的 foup,在封闭的清洗室内 360° 转动清洗。由 DI Water 产生的表面张力、机械力进行 Particle 清洗,离心 + IR/热风进行烘干等工艺组成,高效率、高可靠性完成 foup 的 Particle 清洗。



胜科纳米 (苏州) 股份有限公司
Wintech-Nano (Suzhou) Co., Ltd.

胜科纳米是一家独立的第三方实验室,提供材料分析和失效分析服务。实验室配备了全套的高端分析仪器,并搭建了开放式的专业分析平台 (如高分辨透射电镜、双束聚焦离子束、场发射扫描电镜等),7 天 24 小时不间断的一站式服务,为产品的研发、生产、客服提供最专业最快捷的分析服务。

展示产品

TEM FIB SEM 分析,失效分析,失效定位,无损分析,可靠性,材料表征,DPA

Motic **麦克奥迪实业集团有限公司**
MOTIC CHINA GROUP Co., LTD.

麦克奥迪实业集团有限公司(MOTIC CHINA GROUP CO., LTD.)始创于 1983 年,目前系深交所创业板上市公司麦克奥迪 (厦门) 电气股份有限公司 (证券代码: 300341, 证券简称: 麦克奥迪) 100% 独资控股的企业集团。主营业务为研发、生产和销售光学显微镜、数码显微镜和显微图像集成系统产品。三大类型产品包含近百个型号,主要品牌包括 MOTIC、NATIONAL、SWIFT、CLASSICA 等四大品牌。

WBE威邦 **广东威邦仪器科技股份有限公司**
Guangdong Weibang Instrument Technology Co., Ltd

威邦仪器创业于 1995 年,是一家专业研发、设计、生产、销售各类精密品管检测仪器为一体的高新技术合资企业,并通过 ISO9001、ISO14001 认证。公司总部位于台湾新庄市。主要自行研发生产各种材料的力学性能/耐候 (环境) 性能及寿命测试的可靠性试验机、实验室品质检测设备。客户领域遍及半导体、科研、军工、国防、院校、质检、高分子、LCD、LED、汽车、新能源、光电、精密电子、医疗、通讯



、电器等科技产业。威邦仪器具有多年的生产经验、拥有硬件、软件开发能力及机械设计研发能力，还拥有一支强大技术研发人才队伍，具有丰富的经验、过硬的技术、开阔的思路和创新的能力。尤其在“Case By Case”等专案处理能力为行业内领先水平，产品符合 GB、ISO、BS、ASTM、DIN、UL、EN、CSA、JIS、ISTA 等测试标准。公司在东莞、苏州拥有大型制造基地，东莞、苏州、台湾均设有直销网点。秉承‘一流的品质、完美的服务、永续经营’的企业理念期待成为各大公司实验设备首选供应商！

展示产品

冷热冲击试验箱、高低温/可程式恒温恒湿试验箱、HAST/PCT 高压加速老化试验箱、多功能推拉测试机、拉力试验机（万能材料试验机）、接触角测量仪、厌氧高温试验箱、真空等/大气等离子清洗机、高温老化试验箱、步入式恒温恒湿试验箱、快速温变试验箱、紫外线老化试验箱、氙灯耐气候老化试验箱、臭氧老化试验箱、盐水喷雾试验箱、沙尘试验箱、淋雨试验箱、按键寿命试验机、插拔力试验机、荷重弹力曲线仪、振动试验机、跌落试验机等。

伟达机械有限公司 WYLDAR MACHINE TOOL LIMITED

伟达机械有限公司于 1981 年在香港创立，至今已有 40 年历史，是一家专营高精度数控机床、精密测量仪器及工具的公司。除香港总公司和东莞总部外，于江门及苏州均设立了分公司。伟达机械有限公司属下各分公司是一个专业团队，除持续提升技术的知识，策划最佳的推广活动及专业的售后服务，更与大中华并驾齐驱，共同创造美好的未来。



温馨提示 Conference Guideline

感谢各位嘉宾代表对本次大会的关注与支持，为了更好地为您提供服务，请您留意会务组温馨提示：

Welcome to CICD 2021. Please read this guideline carefully, we will be more than happy to serve you.

- 1 Please always wear your badge during the conference period.
会议期间参会者请佩戴代表证，并凭此参加各项活动
- 2 Meal time and location during the conference (Coupon needed).
会议期间用餐时间和地点（代表凭票用餐）

日期 (Date)	时间 (Time)	用餐地点 (Location)
11 月 1 日 (星期一) Monday, November 1 st	12:00-13:30	二楼澜天自选自助餐厅 2F, LanTian Cafeteria
	17:30-19:00	二楼澜天自选自助餐厅 2F, LanTian Cafeteria
11 月 2 日(星期二) Tuesday, November 2 nd	12:00-13:30	二楼澜天自选自助餐厅 2F, LanTian Cafeteria & 二楼香雪厅 2F, Xiangxue Ballroom
	18:30-21:30	一楼黄埔厅 1F, HuangPu Barllroom
11 月 3 日(星期三) Wednesday, November 3 rd	12:00-13:30	二楼澜天自选自助餐厅 2F, LanTian Cafeteria & 二楼香雪厅 2F, Xiangxue Ballroom

- 3 请妥善保管好自己随身携带手机、电脑、钱包等贵重物品
Please take care of your valuables including cell phones, laptops and wallets.
- 4 会议期间的具体安排请查阅会议日程安排，在会场参会的代表，请将手机调成震动状态，请不要大声喧哗，随意走动，请您配合保持良好的会场秩序
For more details, please read the conference programs. Please switch your phone to 'silent'mode during conference time and help keep the auditorium in good order.
- 5 会议现场负责人 Contact phone number of the conference organizer:

施玥如

电话: [13661508648](tel:13661508648)

邮箱: janey@cepem.com.cn

甘凤华

电话: [15821588261](tel:15821588261)

邮箱: faithsh@yeah.net

陈雯

电话: [13585807781](tel:13585807781)

邮箱: faith@cepem.com.cn